

日月光一〇二年度第二季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 102 年 7 月 26 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇二年度第二季獲利報告，本公司一〇二年度第二季之合併營業收入較一〇二年度第一季成長 5%，較一〇一年同期成長 11%，為新台幣 50,760 百萬元。茲將日月光一〇二年度第二季單季及上半年之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

| 項 目 | 102 年度 第二季 | 102 年度 第一季 | 101 年度 第二季 | 102 年度 上半年 | 101 年度 上半年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 營業收入 | 50,760 | 48,190 | 45,872 | 98,950 | 88,973 |
| 營業毛利 | 10,432 | 8,281 | 8,852 | 18,713 | 16,032 |
| 營業淨利(淨損) | 5,400 | 3,603 | 4,143 | 9,003 | 6,958 |
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 5,038 | 3,159 | 3,732 | 8,197 | 6,305 |
| 所得稅利益(費用) | (1,127) | (803) | (442) | (1,930) | (907) |
| 非控制權益純損(益) | (91) | (125) | (94) | (216) | (156) |
| 本期歸屬予母公司股東淨利(淨損) | 3,820 | 2,231 | 3,196 | 6,051 | 5,242 |
| 稀釋每股盈餘(元) | 0.50 | 0.29 | 0.42 | 0.79 | 0.69 |

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

| 項 目 | 102 年度 第二季 | 102 年度 第一季 | 101 年度 第二季 | 102 年度 上半年 | 101 年度 上半年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 營業收入 | 36,295 | 31,317 | 32,485 | 67,612 | 61,721 |
| 營業毛利 | 8,719 | 6,224 | 7,249 | 14,943 | 12,870 |
| 營業淨利(淨損) | 4,807 | 2,669 | 3,639 | 7,476 | 6,009 |
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 4,833 | 2,776 | 3,534 | 7,609 | 5,946 |
| 所得稅利益(費用) | (975) | (506) | (311) | (1,481) | (666) |
| 非控制權益純損(益) | (38) | (39) | (27) | (77) | (38) |
| 本期歸屬予母公司股東淨利(淨損) | 3,820 | 2,231 | 3,196 | 6,051 | 5,242 |
| 稀釋每股盈餘(元) | 0.50 | 0.29 | 0.42 | 0.79 | 0.69 |

半導體封裝測試營運

| 產 品 結 構 | 占營收比率(%) |
|------------|----------|
| 通訊產品 | 55 |
| 個人電腦 | 11 |
| 汽車及消費性電子產品 | 34 |
| 其他 | 0 |
| 前十大客戶佔營收比重 | 50 |

| 銷 售 地 區 | 占營收比率(%) |
|---------|----------|
| 北美 | 60 |
| 歐洲 | 11 |
| 台灣 | 17 |
| 日本 | 6 |
| 亞洲其他地區 | 6 |

| 封 裝 業 務 產 品 組 合 | 占營收比率(%) |
|---------------------|----------|
| Advanced Packaging | 27 |
| IC Wirebonding | 63 |
| Discrete and Others | 10 |
| 封裝資本支出金額 | 146 百萬美元 |
| 打線機台數 | 15,565 台 |

| 測 試 業 務 產 品 組 合 | 占營收比率(%) |
|-----------------|----------|
| 後段測試 | 80 |
| 晶圓測試 | 18 |
| 前段測試 | 2 |
| 測試資本支出金額 | 74 百萬美元 |
| 測試機台數 | 3,057 台 |

電子製造代工服務之產品結構及客戶組成

| 產 品 結 構 | 占營收比率(%) |
|------------|----------|
| 通訊產品 | 24 |
| 電腦產品 | 29 |
| 消費產品 | 17 |
| 工業產品 | 18 |
| 汽車電子產品 | 10 |
| 其他 | 2 |
| 前十大客戶佔營收比重 | 79 |
| EMS 資本支出金額 | 7 百萬美元 |

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2013 年第三季的業績展望如下：

- 半導體封裝測試材料營收將成長約 1%-5%，電子製造代工服務營收將成長超過 25%；
- 半導體封裝測試材料營業毛利率將持平或微幅成長，電子製造代工服務營業毛利率將下滑約 0.6-0.9 個百分點。
- 全年在設備方面的資本支出將會落在美金 7 億到 7 億 5 仟萬元之間，並根據市場狀況調整。